



# 株式会社フェローテックホールディングス

## 2020年3月期第2四半期決算説明会資料

2019年11月27日

(ジャスダック6890)

<https://www.ferrotec.co.jp>

1. 当期連結決算においては、フェローテックは2019年4月～2019年9月末の業績を、それ以外の連結子会社・持分法適用会社は2019年1月～6月末の業績を連結しております。
2. 本資料は、2020年3月期第2四半期決算の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
3. 本資料は2019年11月27日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり予告なしに変更されることがあります。

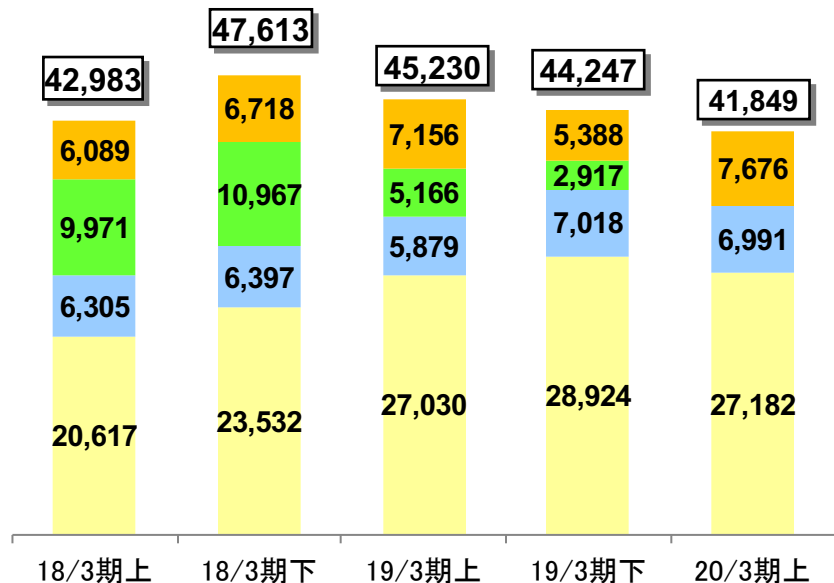


# 2020年3月期第2四半期業績報告

## 売上高の推移

(百万円)

■ 半導体等装置関連 ■ 電子デバイス ■ 太陽電池 ■ その他

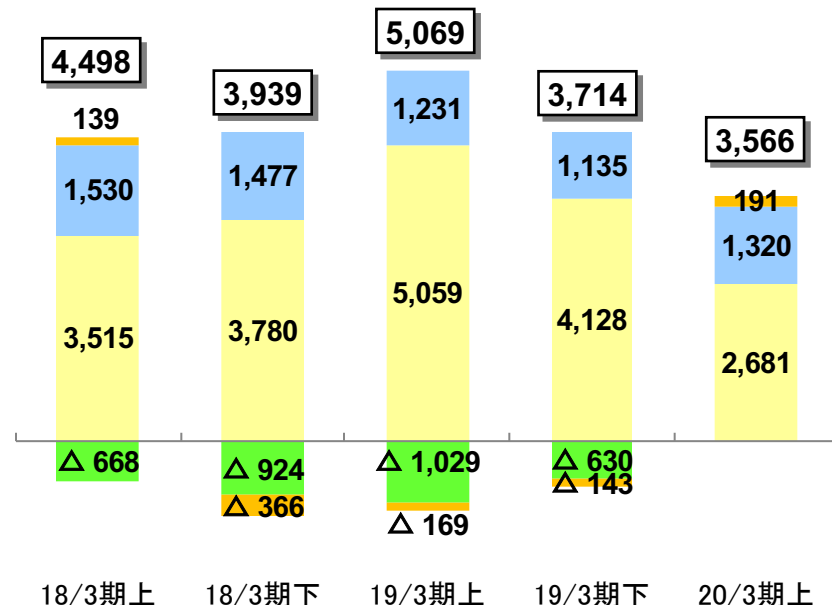


注 装置部品洗浄は18/3期以降半導体等装置関連に含めています  
太陽電池関連事業は20/3期以降その他セグメントに含めています

## 営業利益の推移

(百万円)

■ 半導体等装置関連 ■ 電子デバイス ■ 太陽電池 ■ その他



注 各セグメントの数値の和と合計との差異はセグメント間の取引によるものです  
太陽電池関連事業は20/3期以降その他セグメントに含めています

# 連結決算サマリー

(百万円)	2019年3月期 2Q		2020年3月期 2Q		前期比	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	金額	増減率(%)
売上高	45,231	100.0	41,849	100.0	△ 3,382	△ 7.5
売上原価	31,354	69.3	27,941	66.8	△ 3,413	△ 10.9
売上総利益	13,877	30.7	13,908	33.2	31	0.2
販売管理費	8,808	19.5	10,342	24.7	1,534	17.4
営業利益	5,069	11.2	3,566	8.5	△ 1,503	△ 29.7
営業外収益	611	1.4	786	1.9	175	28.6
営業外費用	814	1.8	1,880	4.5	1,066	131.0
経常利益	4,866	10.8	2,472	5.9	△ 2,394	△ 49.2
特別利益	148	0.3	67	0.2	△ 81	△ 54.7
特別損失	283	0.6	12	0.0	△ 271	△ 95.8
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,826	6.2	1,540	3.7	△ 1,286	△ 45.5
設備投資額	12,030	-	19,123	-	7,093	59.0
減価償却費	2,652	-	3,435	-	783	29.5

注 為替レート2019/3月期→2020/3月期：米ドル 110.36円→109.97円 人民元 16.64円→ 16.23円 (期中平均レート)  
設備投資は、前期設備未払金を考慮した有形・無形固定資産取得のCFベースの数値です

# 連結決算サマリー

百万円	2020年3月期 2Q	
	金額	売上比(%)
売上高	41,849	100.0
売上原価	27,941	66.8
売上総利益	13,908	33.2
販売管理費	10,342	24.7
営業利益	3,566	8.5
営業外収益	786	1.9
営業外費用	1,880	4.5
経常利益	2,472	5.9
特別利益	67	0.2
特別損失	12	0.0
税前利益	2,527	6.0
法人税等合計	1,081	2.6
親会社株主に帰属する当期純利益	1,540	3.7

半導体メモリ等の設備投資の調整局面にあり、真空シールやセラミクス製品等は売上が減少原価率も悪化した。一方前期の減損によりPV製品(その他事業)の原価率は改善し全体では前年69.3%より66.8%に原価率改善

販管費は前年同期比1,533百万円の増加、この要因は、中国子会社での貸倒引当金の計上(前期比435百万円増、研究開発費(前年同期比566百万円増)前年設立の子会社の本格稼働等による

持分法投資利益 181百万円  
 補助金収入 359百万円  
 支払利息 540百万円  
 為替差損 984百万円  
 為替差損は主として中国子会社での円建借入金より発生しています。元円1%の変動で概ね300百万円の為替損益の発生と見ています。

# セグメント別売上高および営業利益

売上高 (単位:百万円)	2019年3月期 2Q		2020年3月期 2Q		前期比	
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	27,580	61.0	27,182	65.0	△ 398	△ 1.4
電 子 デ バ イ ス	5,879	13.0	6,991	16.7	1,112	18.9
そ の 他	11,772	26.0	7,676	18.3	△ 4,096	△ 34.8
合 計	45,231	100.0	41,849	100.0	△ 3,382	△ 7.5

営業利益 (単位:百万円)	2019年3月期 2Q		2020年3月期 2Q		前期比	
	金額	利益率(%)	金額	利益率(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	5,054	18.3	2,681	9.9	△ 2,373	△ 47.0
電 子 デ バ イ ス	1,232	21.0	1,320	18.9	88	7.1
そ の 他	△ 1,195	-	191	2.5	1,386	-
全 社 消 去	△ 22	-	△ 626	-	△ 604	-
合 計	5,069	11.2	3,566	8.5	△ 1,503	△ 29.7

※セグメント変更により、太陽電池関連事業はその他事業に含めて計算しています

# 連結貸借対照表 ～資産～

(百万円)	2019/3期 期末	2020/3期 9月末	増減額
流動資産	77,271	76,282	△ 989
現金及び預金	31,555	28,086	△ 3,469
受取手形及び売掛金	21,461	19,699	△ 1,762
たな卸資産	16,277	17,990	1,713
固定資産	85,827	107,696	21,869
有形固定資産	76,134	100,786	24,653
建物及び構築物	10,789	12,532	1,743
機械装置及び運搬具	18,256	21,676	3,420
工具、器具及び備品	7,595	7,589	△ 6
土地	1,562	1,892	330
リース資産(純額)	405	5,559	5,154
建設仮勘定	37,527	51,538	14,011
無形固定資産	3,557	792	△ 2,765
のれん	166	83	△ 83
投資その他資産	6,136	6,118	△ 18
資産合計	163,098	183,978	20,880

**【流動資産の主な減少要因】**  
大口径ウエハ設備投資支払いにより現金・預金が減少

**【有形固定資産の主な増加要因】**  
①大口径ウエハ設備投資による機械装置・建設仮勘定の増加  
②IFRS16適用の影響により、主に中国子会社でのリース資産計上(約50億円、昨年まで無形固定資産に計上していた土地使用权(約30億円の振替含む))

**【無形固定資産の主な減少要因】**  
土地使用权(約30億円)のリース資産への振替の影響

# 連結貸借対照表 ～負債及び純資産～

(百万円)	2019/3期 期末	2020/3期 9月末	増減額
流動負債	60,180	<b>63,924</b>	3,744
支払手形及び買掛金	20,887	<b>17,987</b>	△ 2,900
短期借入金	9,603	<b>12,183</b>	2,580
1年内返済長期借入金 +1年内償還社債	10,743	<b>13,390</b>	2,647
固定負債	53,070	<b>71,101</b>	18,031
社債	11,225	<b>20,246</b>	9,021
長期借入金	29,505	<b>30,489</b>	984
負債合計	113,250	<b>135,025</b>	21,775
純資産	49,848	<b>48,954</b>	△ 894
株主資本	45,793	<b>46,997</b>	1,204
その他の包括利益累計額	3,705	<b>1,643</b>	△ 2,062
非支配株主持分	324	<b>263</b>	△ 61
負債・純資産合計	163,098	<b>183,978</b>	20,880

## 【流動負債増加の主な要因】

仕入債務(支払手形及び買掛金)は減少しましたが、短期借入金、1年内長借・社債、設備未払金が増加

## 【有利子負債の状況】 ( )内は18/3期末時点の数値

短期借入+1年内長借+1年内社債	25,573百万円	( 20,346 )
長期借入+社債	50,735百万円	( 40,730 )
合計	76,308百万円	( 61,076 )

【ネット有利子負債 48,221百万円 ( 29,521 )】

## 【純資産項目】

純資産の主な変動内訳:

親会社に帰属する当期純利益	1,540百万円
配当金	△ 443百万円
為替換算調整勘定	△ 1,636百万円

注 為替レート2019/3期→2020/3期 : 米ドル 111.00円→107.79円 人民元 16.16円→ 15.69円(期末日レート)



# キャッシュフロー計算書

(百万円)	2019/3期 2Q	2020/3期 2Q
営業活動によるキャッシュフロー	5,403	933
税引前当期純利益	4,731	2,527
減価償却費	2,652	3,435
為替差損益(△:益)	279	405
売上債権の増減(△:増加)	△ 1,324	936
たな卸資産の増減(△:増加)	△ 182	△ 2,131
仕入債務の増減(△:減少)	△ 215	△ 2,768
その他	△ 538	△ 1,471
投資活動によるキャッシュフロー	△ 12,252	△ 19,229
有形固定資産取得による支出	△ 11,115	△ 19,057
有形固定資産の売却による収入	29	18
無形固定資産の取得による支出	△ 915	△ 66
その他	△ 251	△ 124
財務活動によるキャッシュフロー	20,680	14,909
短期借入金の増減額	3,283	2,757
長期借入れによる収入	14,247	6,637
長期借入金の返済による支出	△ 2,890	△ 4,197
社債の発行による収入	6,638	11,154
社債の償還による支出	△ 294	△ 979
配当金の支払額	△ 443	△ 443
その他	139	△ 20
現金及び現金同等物の増加額	13,072	△ 3,591
現金及び現金同等物の期首残高	23,649	31,556
現金及び現金同等物の期末残高	36,720	28,087

## 【営業CFの状況】

税引前利益+減価償却費:	5,962百万円
売上債権減少による営業CFの増加:	936百万円
たな卸資産の増加による営業CFの減少:	△2,131百万円
仕入債務減少による営業CFの減少:	△ 2,768百万円

## 【投資CFの状況】

### 有形固定資産取得支出の主な内容

- ・ 主として大口径ウェハに関わる設備投資146億円

# 通期業績見通し(11/7修正後)

(百万円)	2019/3期	2020/3期(計)	前期比(%)
売上高	89,478	85,000	△ 5.0
営業利益	8,783	6,500	△ 26.0
経常利益	8,060	4,500	△ 44.2
親会社に帰属する 当期純利益	2,846	2,500	△ 12.2
設備投資額	35,953	40,000	11.3
減価償却費	5,755	7,000	21.6

注 為替レート2019/3期→2020/3期予想レート：米ドル110.36円→110.00円 人民元 16.64円→16.00円(期中平均レート)

設備投資は、前期設備未払金を考慮した有形・無形固定資産取得のCFベースの数値です

# 通期業績見通し(セグメント別売上高)

(百万円)	2019/3期	2020/3期(計)	前期比 (%)
半 導 体 等 装 置 関 連	57,026	54,485	△ 4.5
真空シール	11,889	8,055	△ 32.2
石英製品	15,590	16,050	3.0
セラミックス	10,221	8,800	△ 13.9
CVD-SiC	2,800	2,100	△ 25.0
EBガン・LED蒸着装置	4,750	3,880	△ 18.3
ウエーハ加工	7,236	8,100	11.9
装置部品洗浄	3,468	6,400	84.5
石英坩堝(今期より変更)	1,072	1,100	2.6
電 子 デ バ イ ス	12,897	13,300	3.1
サーモモジュール	11,930	12,600	5.6
磁性流体・その他	967	700	△ 27.6
そ の 他	19,555	17,215	△ 12.0
合 計	89,478	85,000	△ 5.0

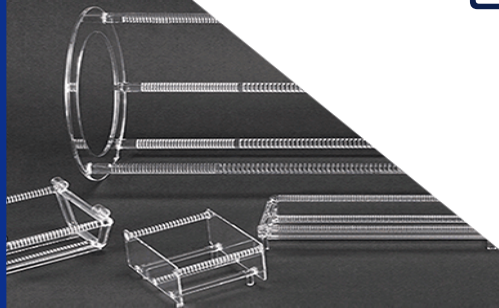
※セグメント変更により、太陽電池関連事業はその他事業に含めて計算しています



**Ferrotec**  
Ferrotec Holdings Corporation



## セグメント別の状況と今後の見通し



**65%** 半導体等装置関連セグメント

<p>真空シール</p>	<p>石英製品</p>
<p>セラミックス製品</p>	<p>CVD-SiC</p>
<p>装置洗浄</p>	<p>シリコンウエーハ</p>

etc...

**17%** 電子デバイスセグメント

<p>磁性流体</p>
<p>サーモモジュール</p>
<p>パワー半導体用基板</p>

**18%** その他

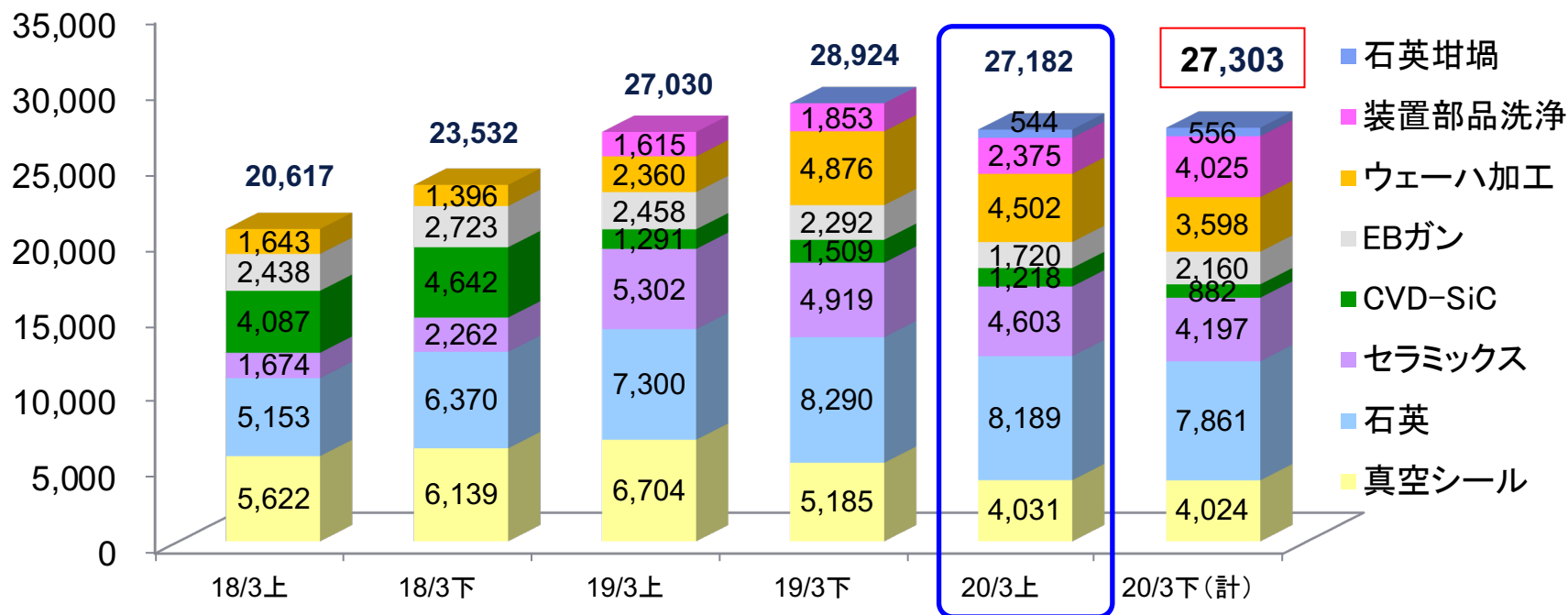
<p>産業用刃物</p>	<p>受託組立</p>
<p>業務用洗濯機</p>	
<p>太陽電池(OEM)</p>	<p>PV用セル</p>
<p>PV用ウエーハ</p>	

etc...

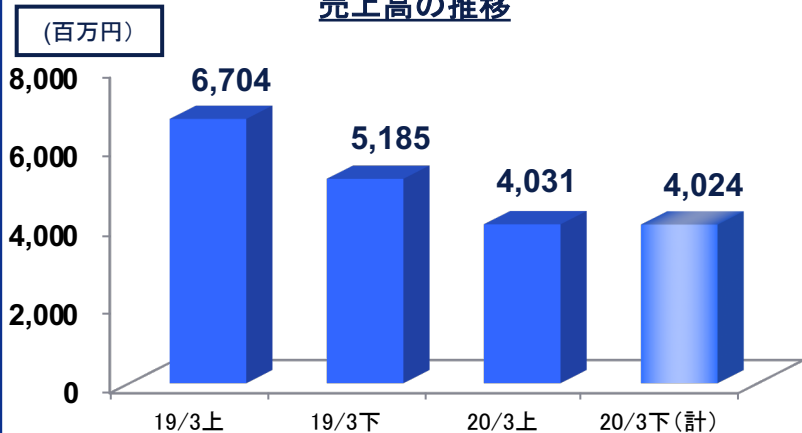
※ 円グラフは2020年3月期第2四半期時点の売上高に占める各セグメントの割合

売上高  
(百万円)

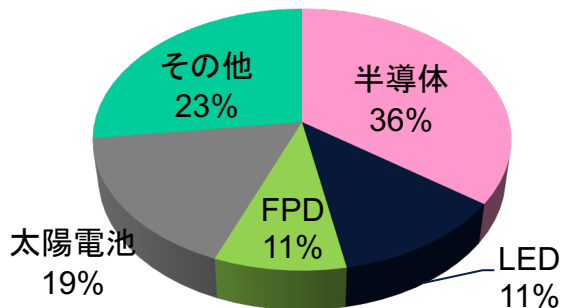
※セグメント計上の変更により、20/3期より石英坩堝を追加



## 売上高の推移



真空シール関連事業の販売先業種別シェア



## 1. 20/3期上期の業績

- 半導体製造装置向けは、メモリー系投資が弱含み、前年同期比で大きく需要が軟化
- FPD市場の有機EL向けは、中国向けで若干需要復調の兆しあり
- 受託加工については、弱含みが続く半導体製造装置用途以外の需要を取り込んだが、前年同期比では減収となる

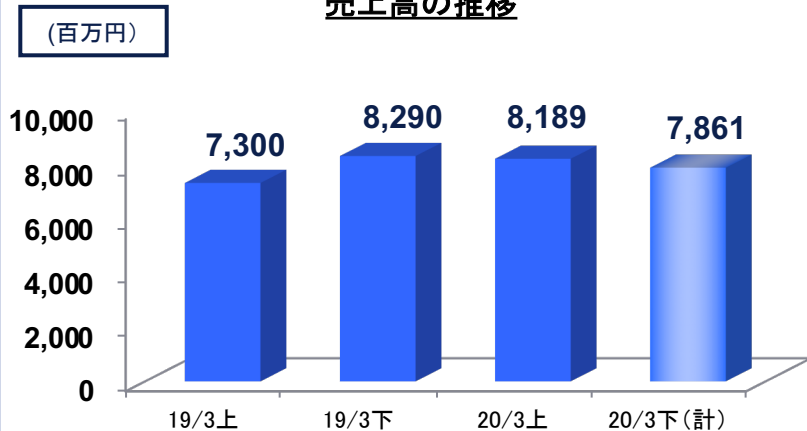
## 2. 20/3期下期の見通し

- 年後半へかけては、半導体、および有機EL製造装置向けが需要復調の見通しとなるが、本格回復は来期上期以降
- 受託加工について、稼働確保の為、非半導体用途の国内外の需要を取り込む予定

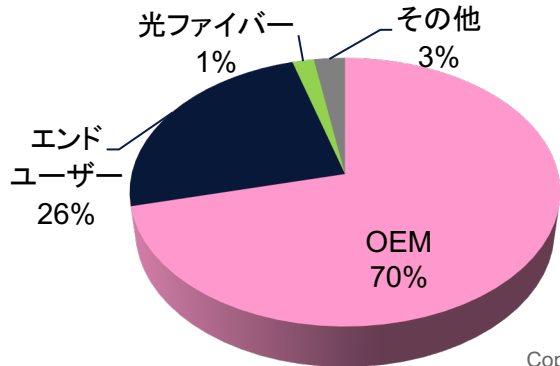
## 《施策》

- 半導体製造装置メーカーとの共同開発を継続
- 大型加工機の設備投資継続
- 当社グループ間の関係を強化しシナジー獲得
- グループ各社の既存チャネル・ブランドを活用し、中国市場での営業強化

## 売上高の推移



石英製品の販売先業種別シェア



### 1. 20/3期上期の業績

- メモリー系 (DRAM、3D-NAND) の半導体製造装置投資は、データセンター投資の一服感と価格による減。但し、ICの生産稼働に基づき、リピータ材の需要は堅調に推移
- 2018年に新設した、中国2拠点 (常山、東台)、及び山形の開発拠点のOEM認定を一部取得
- 微細化高温プロセス向けSiボート、および真空エッチャー向けSiパーツ\*については、堅調に販売が推移

### 2. 20/3期下期の見通し

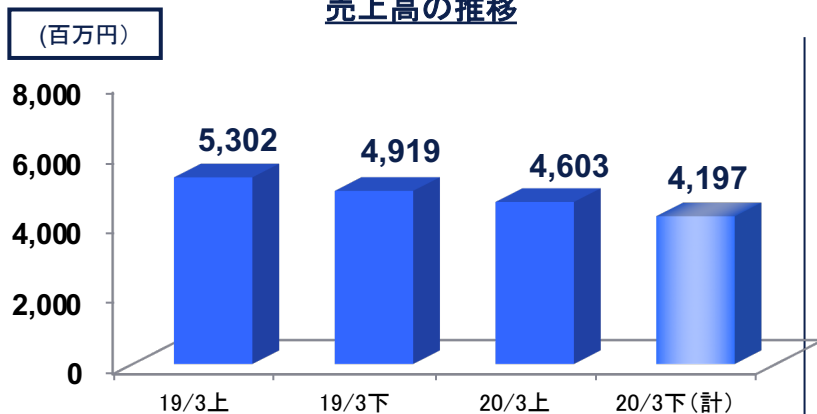
- 半導体装置メーカーの需要は回復傾向であり、下期後半より大手ICメーカー 韓国、台湾、中国での設備投資案件も回復傾向の見通したが、メモリー系については、引き続き不透明な状況が継続
- Siパーツは、中国市場での半導体製造装置向けへの採用も進み、中国ICメーカーもSiボート需要増加。引き続き、堅調な販売の見通し

### 《施策》

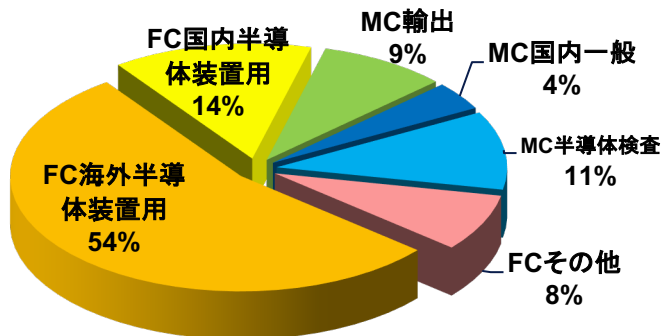
- 大手OEM需要増に備えて、増産体制の準備を実施 (中国 常山工場、東台工場 2拠点新工場稼働中)
- 次世代、次々世代用開発案件の取組み強化 (国内の山形に開発拠点、次世代開発製品の工場 2019年5月より稼働開始。来期以降、本格的に量産ステージへ移行)



## 売上高の推移



セラミックス製品の製品別販売シェア



注) FC: ファイン・セラミックス  
MC: マシナブル・セラミックス(ホトベール)

## 1. 20/3期 (1-6月)の業績

### <マシナブルセラミックス “ホトベール”>

- ・ 国内海外半導体検査治具の販売は堅調
- ・ 海外一部で半導体検査治具材料の販売が低調
- ・ 海外医療関係部品の販売が好調

### <ファインセラミックス>

- ・ 国内 海外半導体装置部品の販売が低調

## 2. 20/3期 (7-12月)の見通し

### <マシナブルセラミックス “ホトベール”>

- ・ 国内海外の新型半導体検査治具の好調が見込まれる
- ・ 海外半導体検査治具材料の販売増加が見込まれる

### <ファインセラミックス>

- ・ 海外エッチング装置部品の販売が低調
- ・ 国内成膜装置各部品の販売が復調

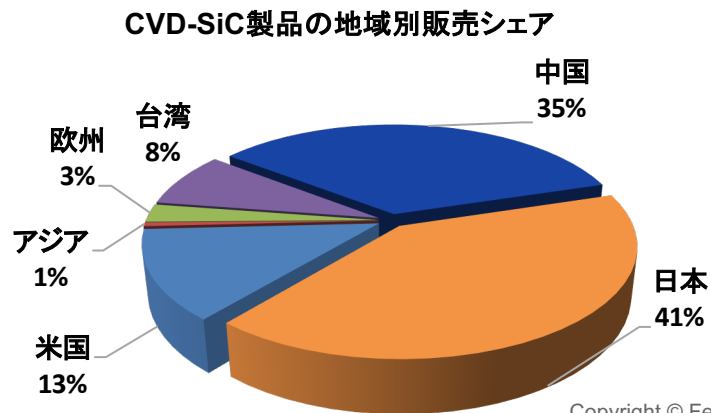
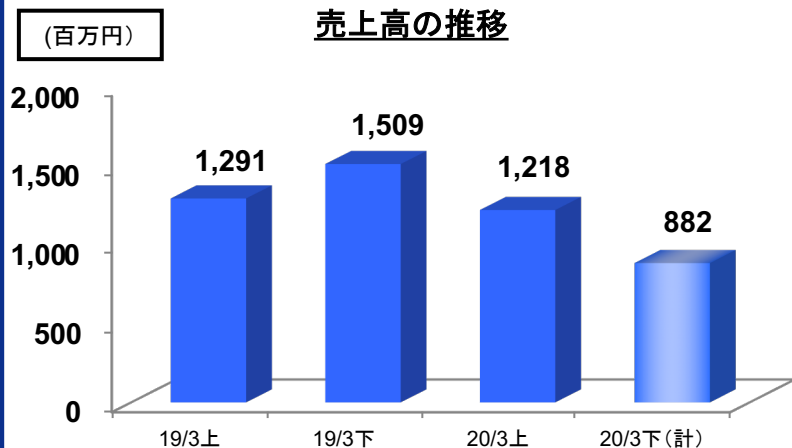
## 3. 継続販売方針

### <マシナブルセラミックス>

- ・ 微細化に伴う新型検査治具の引き合いが好調で、販売に注力する
- ・ 高機能物性を持ったマシナブルセラミックス材料の拡販に注力する
- ・ 海外医療関係部品など引き合いが好調で販売増を目指す

### <ファインセラミックス>

- ・ 国内外の半導体装置に関してバラツキはあるが、全体に回復傾向にあり部品需要が出てきたため販売増加を目指す。また、一般産業機械部品などへ幅広く拡販を目指す



## 1. 20/3期(1-6月)の業績

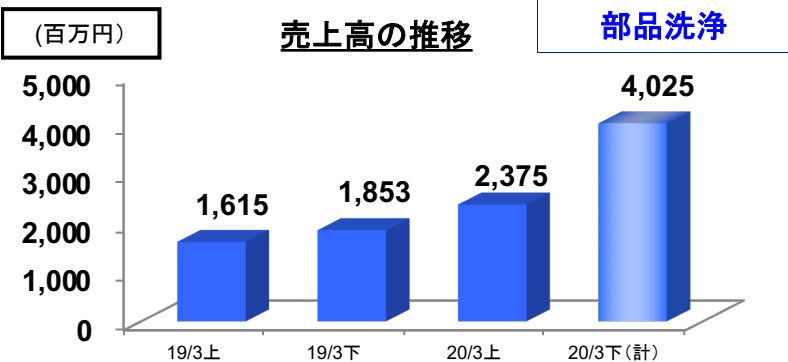
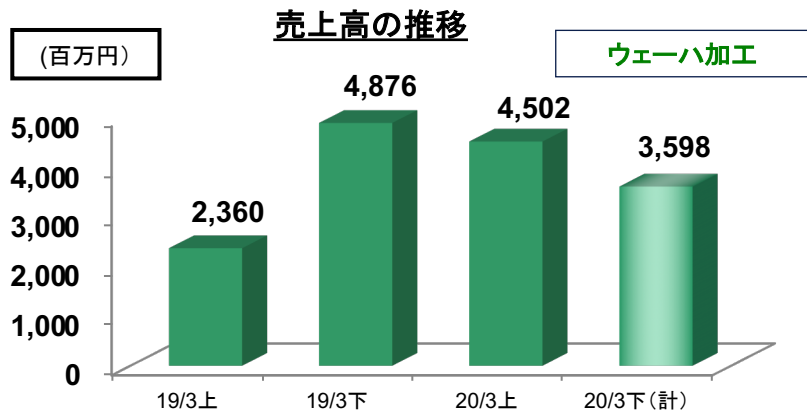
- 半導体製造装置向け部材は、装置投資の延期及び在庫調整の影響を受け低調であった
- SiCエピ向け高純度耐熱部材は、装置メーカーの販売が好調であり、堅調に推移した。

## 2. 20/3期下期の見通し

- 半導体製造装置向け部材は、年内の回復は厳しい
- SiCエピ向け高純度耐熱材料は堅調に推移する

## 《施策》

- 半導体エッチャー装置、LED製造装置向け消耗部材の拡販、生産体制の整備
- SiC半導体に関わる開発・試作体制の強化
- 中国の半導体製造装置メーカ、デバイスメーカーへの新規採用



## 半導体ウェーハ:

### 1. 20/3期上期の業績

- ・ 6インチは19/3下期比ではやや需給軟化も前年同期比36%の増収
- ・ 8インチは産業機器向けなどの需要調整もあり、売上が伸び悩み

### 2. 20/3期下期の見通し

- ・ 6インチ、8インチ共、20/3上比較で、需要が弱含み減収の見通し
- 《施策》
- ・ 8インチは杭州新工場での装置搬入を行い、来期1Qより量産開始
  - ・ 杭州の量産立上は、今後需要見合いで段階的に実施。最終的には、月産45万枚体制を構築(上海 10万枚含む)

## 部品洗浄:

### 1. 20/3期上期の業績

- ・ 安徽省の銅陵、四川省内江第二工場の新設工場が売上に寄与し、5拠点6工場体制確立。前年同期比47%の増収を実現

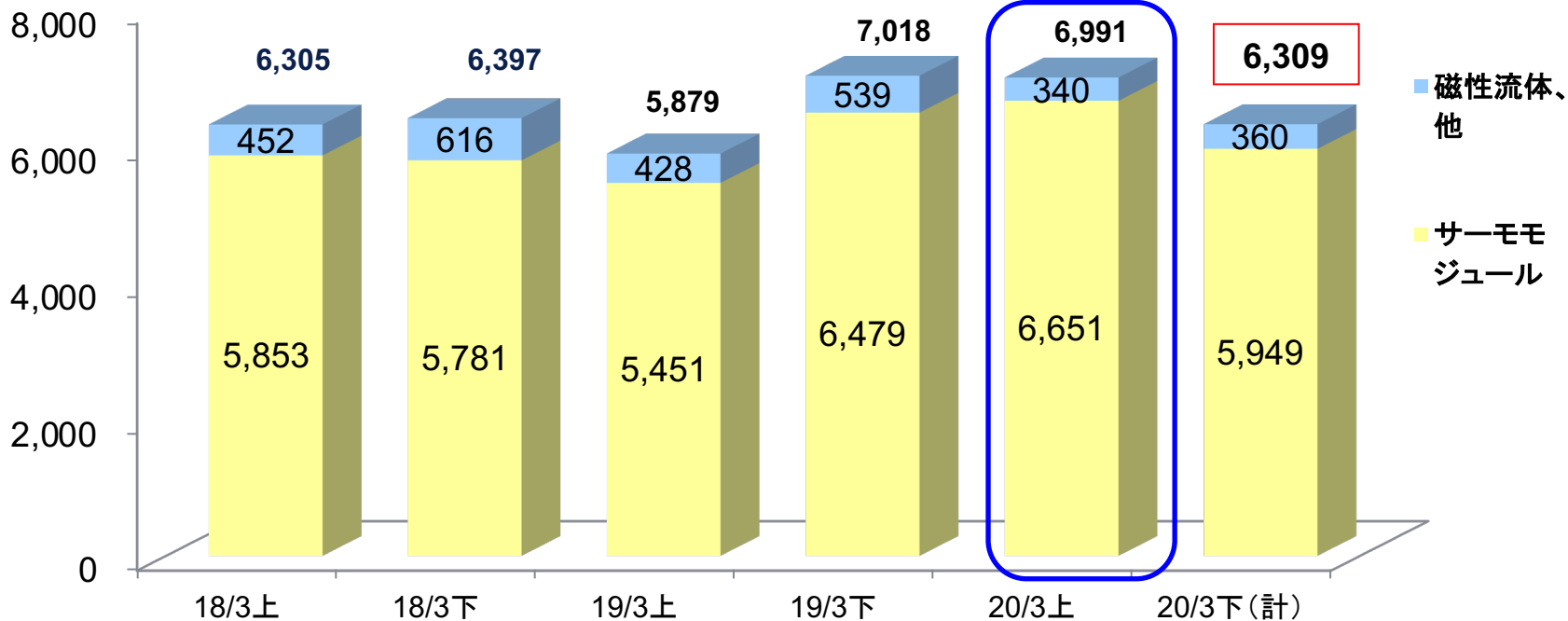
### 2 20/3期下期の見通し

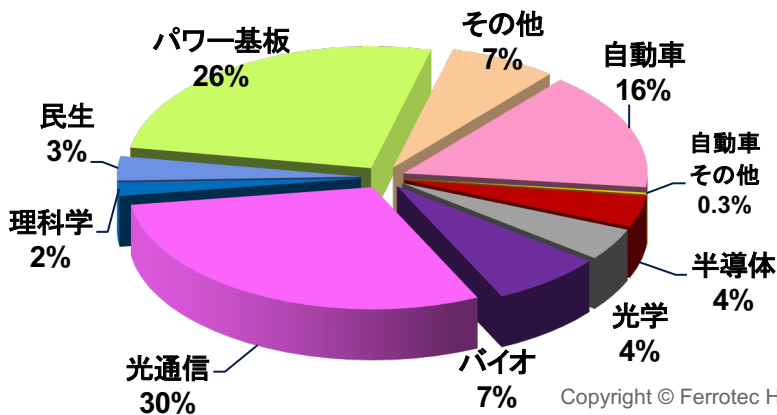
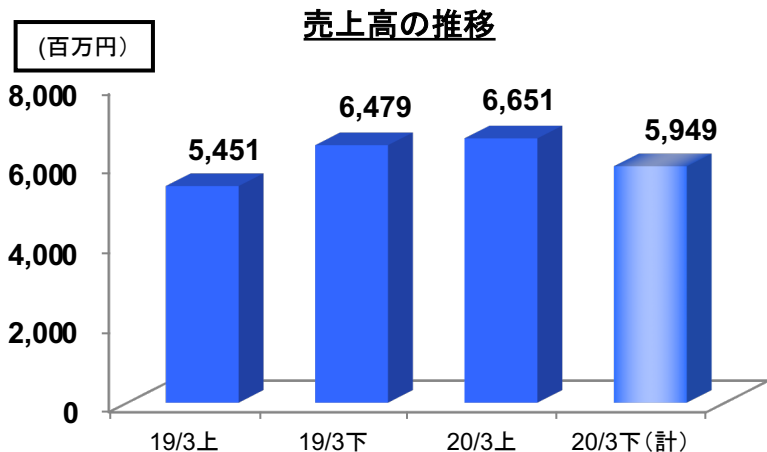
- ・ 中国国内の半導体デバイスメーカー、FPDメーカーの生産規模拡大を見込み、下期も大幅増収の見通し

### 《施策》

- ・ 部品洗浄事業は、安徽省の銅陵工場を主力孫会社として組織再編。今後は上海に分析センターを設け、より最先端分野を取り込む

売上高  
(百万円)





## 1. 20/3期上期の業績

### 自動車向け

- 温調シートは前年同期比9%の減収
- 次世代自動車向けの温調用途での試作、マーケティングを強化

### その他の産業向け

- 中国の通信機器向けが大きく伸長、バイオ向けも堅調に推移
- パワー基板は新拠点の生産能力増強で、前年同期比113%の増収

## 2. 20/3期下期の見通し

### 自動車向け

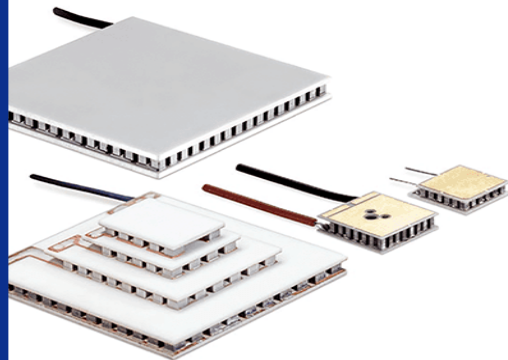
- 温調シートの需要は引き続き弱含みの見通し
- 自動車新用途は、将来の採用確度の高い案件にフォーカス

### その他の産業向け

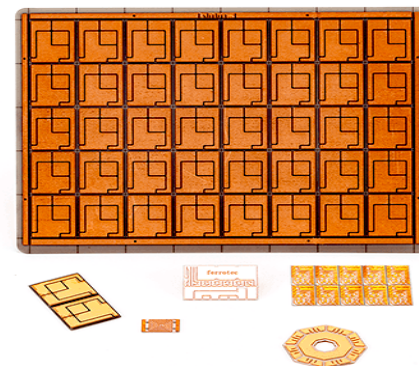
- 5G関連の通信機器、新时期ウェアラブル用途などの伸長を期待
- パワー基板は、産業機器や家電向けの調整で減収の見通し

### 《施策》

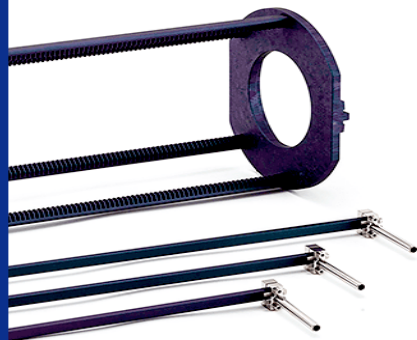
- サーモモジュールのサブアッセンブリ品の世界的拡販活動を展開
- 自動車向けアプリケーション開拓の更なる強化(量産化 3~5年)
- パワー基板は、自動車向け窒化ケイ素(AMB基板)の開拓強化









**Ferrotec**  
Ferrotec Holdings Corporation



## Appendix

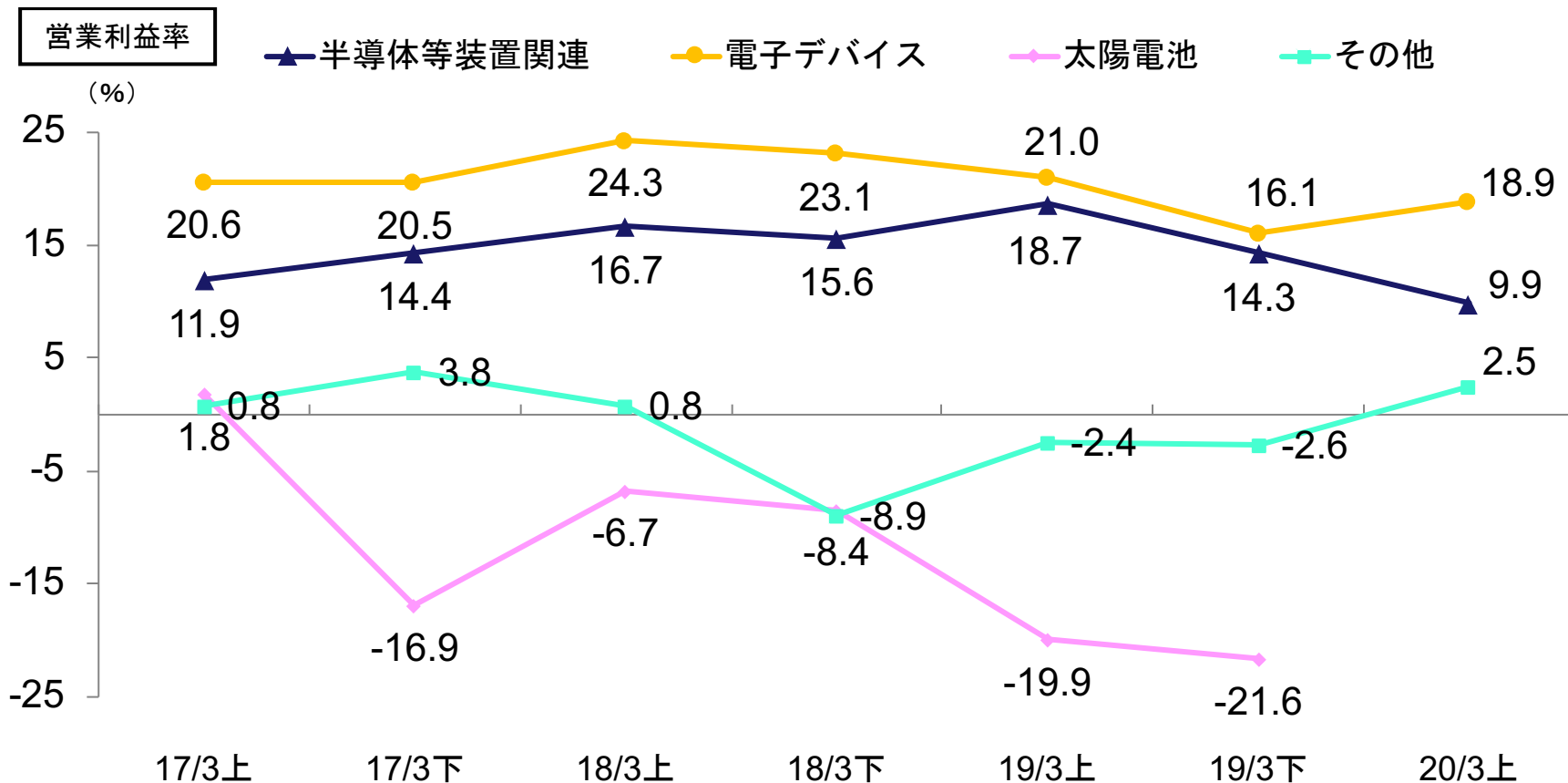


商号	株式会社フェローテックホールディングス 英語表記 : Ferrotec Holdings Corporation
設立	1980年9月27日
本社	東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル5F
上場	JASDAQスタンダード (証券コード:6890)
代表者	代表取締役社長 山村 章
事業内容	グループ会社の経営管理、研究開発業務
資本金	17,646百万円
発行済株式数	37,203,702株(自己株式93,568株を含む)
関連会社	【連結子会社】42社 【持分法適用子会社】6社
従業員	【連結】7,408名 【単体】81名

1980年～	1990年～	2000年～
<p>磁性流体・応用製品 (CPシール・真空シール) の製造・販売を開始</p> <p>真空シール</p> 	<p>92年～: サーモモジュール・モジュール の製造・販売を中国で開始</p> <p>98年～: 半導体関連事業向け石英 製品の製造・販売を開始</p> <p>サーモモジュール</p>  <p>石英</p> 	<p>02年～: シリコンウェハー加工・工作機械等の 受託事業を開始(上海工場)</p> <p>05年～: 太陽電池関連事業を開始 インゴット・結晶製造装置 ・坩堝の製造・販売</p> <p>08年～: セラミックス製品の製造・開発を開始</p> <p>インゴット</p>  <p>単結晶製造装置</p>  <p>マシナブルセラミックス</p> 
<p>磁性流体技術を核に</p> <p>～ 当社グループ事業のコア となる技術 ～</p>	<p>積極的に海外へ進出</p> <p>91年～: 米国マサチューセッツ州に法人設立</p> <p>92年～: 中国杭州に法人設立</p> <p>95年～: 中国上海に法人設立</p> <p>97年～: シンガポールに法人設立</p> <p>99年～: フェローフルイディクス社を買収、 北米・欧州への展開を開始</p>	<p>新たな収益基盤を確立</p> <p>02年～: 中国上海工場にてシリコンウェーハ加工・工作機械 等の受託事業(CMS)を開始</p> <p>部品加工～組立までの一貫した生産技術の蓄積がCMS事 業への進出を実現</p> <p>05年～: 中国杭州にて太陽電池関連製品の製造・ 販売を強化</p>



# セグメント別営業利益率の推移



# 業績比較(20/3期上期計画(11/7修正前)と実績)

百万円	2020年3月期上期 実績		2020年3月期上期 計画(11/7修正前)			
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	27,182	65.0	29,000	64.4	1,818	6.7
真空シール	4,031	9.6	4,000	8.9	△ 31	△ 0.8
石英製品	8,189	19.6	8,300	18.4	111	1.4
セラミックス	4,603	11.0	5,000	11.1	397	8.6
CVD-SiC	1,218	2.9	1,300	2.9	82	6.7
EBガン・LED蒸着装置	1,720	4.1	1,900	4.2	180	10.5
ウェーハ加工	4,502	10.8	4,700	10.4	198	4.4
部品洗浄	2,375	5.7	3,000	6.7	625	26.3
石英坩堝	544	1.3	800	1.8	256	47.1
電 子 デ バ イ ス	6,991	16.7	7,100	15.8	109	1.6
サーモモジュール	6,651	15.9	6,500	14.4	△ 151	△ 2.3
磁性流体・その他	340	0.8	600	1.3	260	76.5
そ の 他	7,676	18.3	8,900	19.8	1,224	15.9
合 計	41,849	100.0	45,000	100.0	3,151	7.5
売 上 総 利 益	13,908	33.2	13,661	30.4	△ 247	△ 1.8
販 売 管 理 費	10,342	24.7	9,339	20.8	△ 1,003	△ 9.7
営 業 利 益	3,566	8.5	4,322	9.6	756	21.2
経 常 利 益	2,472	5.9	4,000	8.9	1,528	61.8
四 半 期 純 利 益	1,540	3.7	2,300	5.1	760	49.4

# 業績比較(20/3期 上期と下期計画値(11/7修正後))

百万円	2020年3月期上期 実績		2020年3月期下期 計画			
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	27,182	65.0	27,303	63.3	121	0.4
真空シール	4,031	9.6	4,024	9.3	△ 7	△ 0.2
石英製品	8,189	19.6	7,861	18.2	△ 328	△ 4.0
セラミックス	4,603	11.0	4,197	9.7	△ 406	△ 8.8
CVD-SiC	1,218	2.9	882	2.0	△ 336	△ 27.6
EBガン・LED蒸着装置	1,720	4.1	2,160	5.0	440	25.6
ウェーハ加工	4,502	10.8	3,598	8.3	△ 904	△ 20.1
部品洗浄	2,375	5.7	4,025	9.3	1,650	69.5
石英坩堝	544	1.3	556	1.3	12	2.2
電 子 デ バ イ ス	6,991	16.7	6,309	14.6	△ 682	△ 9.8
サーモモジュール	6,651	15.9	5,949	13.8	△ 702	△ 10.6
磁性流体・その他	340	0.8	360	0.8	20	5.9
そ の 他	7,676	18.3	9,539	22.1	1,863	24.3
合 計	41,849	100.0	43,151	100.0	1,302	3.1
売 上 総 利 益	13,908	33.2	13,497	31.3	△ 411	△ 3.0
販 売 管 理 費	10,342	24.7	10,538	24.4	196	1.9
営 業 利 益	3,566	8.5	2,934	6.8	△ 632	△ 17.7
経 常 利 益	2,472	5.9	2,028	4.7	△ 444	△ 18.0
四 半 期 純 利 益	1,540	3.7	960	2.2	△ 580	△ 37.7

# 業績比較(19/3期 上期と20/3期 上期)

百万円	2019年3月期上期 実績		2020年3月期上期 実績			
半 導 体 等 装 置 関 連	27,580	61.0	27,182	65.0	△ 398	△ 1.4
真空シール	6,704	14.8	4,031	9.6	△ 2,673	△ 39.9
石英製品	7,300	16.1	8,189	19.6	889	12.2
セラミックス	5,302	11.7	4,603	11.0	△ 699	△ 13.2
CVD-SiC	1,291	2.9	1,218	2.9	△ 73	△ 5.7
EBガン・LED蒸着装置	2,458	5.4	1,720	4.1	△ 738	△ 30.0
ウェーハ加工	2,360	5.2	4,502	10.8	2,142	90.8
部品洗浄	1,615	3.6	2,375	5.7	760	47.1
石英坩堝(セグメント変更後)	550	1.2	544	1.3	△ 6	△ 1.1
電 子 デ バ イ ス	5,879	13.0	6,991	16.7	1,112	18.9
サーモジュール	5,451	12.1	6,651	15.9	1,200	22.0
磁性流体・その他	428	0.9	340	0.8	△ 88	△ 20.6
そ の 他	11,772	26.0	7,676	18.3	△ 4,096	△ 34.8
合 計	45,231	100.0	41,849	100.0	△ 3,382	△ 7.5
売 上 総 利 益	13,877	30.7	13,908	33.2	31	0.2
販 売 管 理 費	8,808	19.5	10,342	24.7	1,534	17.4
営 業 利 益	5,069	11.2	3,566	8.5	△ 1,503	△ 29.7
経 常 利 益	4,866	10.8	2,472	5.9	△ 2,394	△ 49.2
四 半 期 純 利 益	2,896	6.4	1,540	3.7	△ 1,356	△ 46.8

# 業績比較(19/3期 実績と20/3期 計画値(11/7修正後))

百万円	2019年3月期 実績		2020年3月期 計画			
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)	増減額	増減率(%)
半 導 体 等 装 置 関 連	57,026	63.7	54,485	64.1	△ 2,541	△ 4.5
真空シール	11,889	13.3	8,055	9.5	△ 3,834	△ 32.2
石英製品	15,590	17.4	16,050	18.9	460	3.0
セラミックス	10,221	11.4	8,800	10.4	△ 1,421	△ 13.9
CVD-SiC	2,800	3.1	2,100	2.5	△ 700	△ 25.0
EBガン・LED蒸着装置	4,750	5.3	3,880	4.6	△ 870	△ 18.3
ウエーハ加工	7,236	8.1	8,100	9.5	864	11.9
部品洗浄	3,468	3.9	6,400	7.5	2,932	84.5
石英坩堝(今期より変更)	1,072	0.12	1,100	1.3	28	2.6
電 子 デ バ イ ス	12,897	14.4	13,300	15.6	403	3.1
サーモモジュール	11,930	13.3	12,600	14.8	670	5.6
磁性流体・その他	967	1.1	700	0.8	△ 267	△ 27.6
そ の 他	19,555	21.9	17,215	20.3	△ 2,340	△ 12.0
合 計	89,478	100.0	85,000	100.0	△ 4,478	△ 5.0
売 上 総 利 益	27,137	30.3	27,405	32.2	268	1.0
販 売 管 理 費	18,354	20.5	20,880	24.6	2,526	13.8
営 業 利 益	8,783	9.8	6,500	7.6	△ 2,283	△ 26.0
経 常 利 益	8,060	9.0	4,500	5.3	△ 3,560	△ 44.2
当 期 純 利 益	2,846	3.2	2,500	2.9	△ 346	△ 12.2
設 備 投 資 額	35,953	-	40,000	-	4,047	12.6
減 価 償 却 費	5,755	-	7,000	-	1,245	21.6

# Thank You

